



平成30年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成29年8月14日

上場会社名 株式会社フェローテックホールディングス

上場取引所 東

コード番号 6890 URL <http://www.ferrotec.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 山村 章

問合せ先責任者 (役職名) 代表取締役副社長 (氏名) 山村 文 TEL 03-3281-8186

四半期報告書提出予定日 平成29年8月14日 配当支払開始予定日 ー

四半期決算補足説明資料作成の有無： 無

四半期決算説明会開催の有無： 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成30年3月期第1四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29年6月30日）

(1) 連結経営成績（累計） (%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
30年3月期第1四半期	20,793	20.8	2,268	38.5	1,747	77.5	925	103.9
29年3月期第1四半期	17,213	2.7	1,637	95.1	984	16.7	454	△22.2

(注) 包括利益 30年3月期第1四半期 △88百万円 (ー%) 29年3月期第1四半期 △1,465百万円 (ー%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
30年3月期第1四半期	29.85	29.64
29年3月期第1四半期	14.74	14.67

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
30年3月期第1四半期	95,232	41,063	42.5	1,263.12
29年3月期	92,100	39,701	42.6	1,271.76

(参考) 自己資本 30年3月期第1四半期 40,490百万円 29年3月期 39,223百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
29年3月期	ー	6.00	ー	12.00	18.00
30年3月期	ー				
30年3月期(予想)		10.00	ー	10.00	20.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

3. 平成30年3月期の連結業績予想（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	42,000	11.6	4,400	30.3	3,700	75.5	2,100	103.1	65.18
通期	83,000	12.4	8,200	44.4	7,100	25.1	4,200	29.0	126.77

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無
新規 ー社 （社名）ー、除外 ー社 （社名）ー

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 有

（注）詳細は、添付資料 8 ページ「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 （3）四半期連結財務諸表に関する注記事項（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	30年3月期1Q	32,149,402株	29年3月期	30,935,702株
② 期末自己株式数	30年3月期1Q	93,496株	29年3月期	93,496株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	30年3月期1Q	31,020,422株	29年3月期1Q	30,810,262株

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料 3 ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報 （3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第1四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	8
(会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示)	8
(セグメント情報等)	9

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間における経済状況は、米国は緩やかに拡大しており、雇用統計や企業収益も堅調であり、FRBは6月中旬に追加利上げを実施しました。欧州では、各国の政局が安定しており景気回復が期待されています。一方、GDP世界第2位の中国は、内需拡大を主とした経済政策により、経済成長が継続されています。我が国では、企業業績が堅調であり、緩やかな拡大に転じつつあると報じられておりますが、消費者物価指数は足踏みの状況です。

当社グループの属するエレクトロニクス産業では、半導体の設備投資が続いており、NAND型フラッシュメモリが品不足となり、自動車搭載用のセンサーやパワー半導体などの需要が旺盛です。大型液晶パネルに続き有機ELパネルの設備投資が拡大しており、新型スマートフォンへの採用や家電メーカーからは4K有機ELテレビの発表が相次いでいます。

このような事業環境のなか、当社グループの半導体等装置関連事業におきましては、有機ELパネル製造装置向けの真空シールが好調であり、金属精密加工技術を用いたエンジニアリング・サービスの受託製造も増加しています。また、半導体製造装置メーカーやデバイスメーカーからの旺盛な需要があるマテリアル製品は堅調に推移しました。電子デバイス事業におきましては、主力のサーモモジュールは、次世代型の移動通信システムの通信機器用途が好調であり、北米自動車向けの温調シートは、概ね計画のとおりでした。太陽電池関連事業におきましては、同事業の不採算製品の構造改革策を進めており、前四半期と比べ損失幅が縮小しております。

この結果、当第1四半期連結累計期間における売上高は20,793百万円（前年同期比20.8%増）、営業利益は2,268百万円（前年同期比38.5%増）、経常利益は1,747百万円（前年同期比77.5%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は925百万円（前年同期比103.9%増）となりました。

なお、当第1四半期連結会計期間より従来「装置関連事業」としていた報告セグメントの名称を「半導体等装置関連事業」に変更しております。この変更はセグメント名称の変更であり、セグメント情報に与える影響はありません。

当第1四半期連結累計期間のセグメントの業績は、次のとおりであります。

(半導体等装置関連事業)

当該事業の主な製品は、真空シール及び各種製造装置向け金属加工製品、石英製品、セラミックス製品、CVD-SiC製品、シリコンウエーハ加工などです。

主力の真空シールは、半導体および有機ELパネルなどの製造装置内に装着され、密封空間を保持する機能部品です。半導体の微細化投資や新型スマートフォン向け有機ELパネルの投資が進んだ結果、同製造装置部品が伸長しており、足元の引合いも増加しています。一方、石英製品、セラミックス製品、CVD-SiC製品など半導体のウエーハプロセスに使用されるマテリアル製品は、データセンター等のサーバー用SSD（ソリッドステートドライブ）やスマートフォン用フラッシュメモリなどの需要が旺盛であり、デバイスメーカー各社の装置稼働率は高水準で推移しております。このため、一部製品では供給不足が発生しており、当社グループではマテリアル製品の製造ラインの拡張を実施中であり、新工場建築や増産ラインの追加投資を進めております。シリコンウエーハ加工は、6インチ小口径ウエーハを利用する車載用途やセンサー類などの需要が増加傾向となりました。新設の8インチウエーハ工場につきましては、本年7月に竣工式を行い、評価用サンプルの出荷が開始されました。

当該事業は、半導体製造装置の投資及び稼働率に連動しますが、底堅く推移する見込みです。

この結果、当該事業の売上高は10,026百万円（前年同期比29.7%増）、営業利益は1,647百万円（前年同期比86.7%増）となりました。

(太陽電池関連事業)

当該事業の主な製品は、シリコン結晶製造装置、シリコン製品、石英坩堝などです。

太陽電池産業は、パリ協定のCO₂削減策の実施に向け、再生エネルギーである太陽光発電の設置量が世界的に拡大しており、インドを中心とした新興国での需要が活発化しております。当社のシリコン製品と太陽電池セルの需要も旺盛でしたが、前年度の駆け込み需要反動の相場環境が続いており、若干ながら営業損失を計上しました。需要は旺盛なことから、競争力のある単結晶N型に特化し、また発電効率を向上させるPERC技術を導入しており、歩留り向上に努め利益確保を実現してまいります。

当該事業では、事業構造改革の一環として、シリコン結晶製造装置を半導体8インチ用途に技術転用し、既に自社での稼働が始まりました。消耗品である石英坩堝は、得意先への供給責任を果たしながら、その他を半導体用途へ移管しており、今後も事業構造改革を進め収益改善に努めてまいります。

この結果、当該事業の売上高は4,386百万円（前年同期比5.8%減）、営業損失は222百万円（前年同期は174百万円の営業利益）となりました。

(電子デバイス事業)

当該事業の主な製品は、サーモモジュール、パワー半導体用基板、磁性流体などです。

主力の自動車温調シート向けサーモモジュールは、北米市場での自動車販売台数が前年比で減少したものの、温調シート搭載の高級車は底堅く推移しました。一方、中国における移動通信システムの切替需要により、中国の通信機器メーカーからの受注が堅調でした。医療検査装置やバイオ関連機器用途は、概ね計画のとおり推移しました。パワー半導体用基板は、新たな顧客からの受注を得たことから増産体制を構築しております。磁性流体は、車載スピーカー用途のほか、スマートフォンのバイブレーション機構への採用が進み堅調に推移しました。

当該事業のサーモモジュールは、景気に左右されにくい業種への販売が大勢を占めることから、緩やかな業容拡大を目指す安定的な事業です。今後は単品販売からユニット製品（製品・電源・基板等を組立）の販売に注力してまいります。

この結果、当該事業の売上高は3,223百万円（前年同期比5.4%増）、営業利益は804百万円（前年同期比34.1%増）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

<資産>

当第1四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末と比べ3,131百万円減少し、95,232百万円となりました。これは主として、受取手形及び売掛金88百万円の減少によるものであります。

<負債>

当第1四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比べ△1,769百万円減少し、54,168百万円となりました。これは主として、長期借入金897百万円の減少によるものであります。

<純資産>

当第1四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比べ1,362百万円減少し、41,063百万円となりました。これは主として、利益剰余金555百万円の増加と為替換算調整勘定1,056百万円の減少によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、平成29年5月15日の「平成29年3月期 決算短信」で公表いたしました業績予想を修正しております。

なお、詳細につきましては、本日公表いたしました「第2四半期業績予想と通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	14,778,484	16,416,889
受取手形及び売掛金	17,656,153	17,568,018
商品及び製品	4,928,085	4,540,290
仕掛品	3,937,238	4,279,013
原材料及び貯蔵品	5,017,758	5,601,705
その他	5,718,492	5,134,909
貸倒引当金	△790,699	△747,757
流動資産合計	51,245,512	52,793,068
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	8,583,979	8,855,669
機械装置及び運搬具(純額)	8,454,459	8,601,660
工具、器具及び備品(純額)	5,908,902	5,705,770
土地	1,280,883	1,582,522
リース資産(純額)	634,920	600,406
建設仮勘定	9,431,770	10,682,940
有形固定資産合計	34,294,915	36,028,969
無形固定資産		
のれん	769,624	716,864
その他	1,291,250	1,233,076
無形固定資産合計	2,060,875	1,949,941
投資その他の資産		
その他	5,003,447	4,957,774
貸倒引当金	△503,926	△496,966
投資その他の資産合計	4,499,520	4,460,808
固定資産合計	40,855,311	42,439,719
資産合計	92,100,823	95,232,787

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	13,926,728	15,336,104
短期借入金	5,002,482	5,237,122
1年内返済予定の長期借入金	4,538,890	4,421,985
未払法人税等	527,110	687,257
賞与引当金	1,007,367	888,397
その他	7,106,356	7,768,493
流動負債合計	32,108,935	34,339,360
固定負債		
長期借入金	12,625,317	11,727,827
退職給付に係る負債	492,197	499,973
役員退職慰労引当金	50,650	52,000
資産除去債務	84,004	84,164
その他	7,038,554	7,465,568
固定負債合計	20,290,723	19,829,533
負債合計	52,399,658	54,168,894
純資産の部		
株主資本		
資本金	13,215,838	14,089,882
資本剰余金	14,031,324	14,905,368
利益剰余金	6,047,719	6,603,529
自己株式	△86,464	△86,464
株主資本合計	33,208,418	35,512,315
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	106,073	123,453
為替換算調整勘定	6,036,407	4,979,742
退職給付に係る調整累計額	△127,147	△125,181
その他の包括利益累計額合計	6,015,333	4,978,014
新株予約権	23,567	31,904
非支配株主持分	453,846	541,659
純資産合計	39,701,165	41,063,893
負債純資産合計	92,100,823	95,232,787

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年6月30日)
売上高	17,213,935	20,793,281
売上原価	12,339,704	14,807,803
売上総利益	4,874,230	5,985,477
販売費及び一般管理費	3,237,061	3,717,325
営業利益	1,637,168	2,268,151
営業外収益		
受取利息	6,995	8,826
持分法による投資利益	66,111	49,391
その他	91,921	83,812
営業外収益合計	165,028	142,031
営業外費用		
支払利息	120,231	157,559
為替差損	538,215	336,750
その他	159,011	168,179
営業外費用合計	817,458	662,489
経常利益	984,738	1,747,692
特別利益		
固定資産売却益	892	—
特別利益合計	892	—
特別損失		
固定資産処分損	37,100	—
投資有価証券評価損	—	19,157
特別損失合計	37,100	19,157
税金等調整前四半期純利益	948,530	1,728,535
法人税等	500,914	777,462
四半期純利益	447,615	951,072
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	△6,451	25,156
親会社株主に帰属する四半期純利益	454,066	925,916

(四半期連結包括利益計算書)
(第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
四半期純利益	447,615	951,072
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△26,923	17,379
為替換算調整勘定	△1,871,136	△1,061,429
退職給付に係る調整額	3,031	1,966
持分法適用会社に対する持分相当額	△18,044	2,260
その他の包括利益合計	△1,913,073	△1,039,823
四半期包括利益	△1,465,458	△88,750
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△1,434,306	△111,402
非支配株主に係る四半期包括利益	△31,151	22,652

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

(税金費用の計算)

税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。また、見積実効税率を使用できない場合は、税引前四半期純利益に一時差異に該当しない重要な差異を加減した上で、法定実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は、法人税等を含めて表示しております。

(会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第1四半期連結累計期間(自平成28年4月1日 至平成28年6月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント				その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注3)
	半導体 等装置関連 事業	太陽電池 関連事業	電子デバ イス事業	計				
売上高								
(1)外部顧客への 売上高	7,733,241	4,654,911	3,057,648	15,445,801	1,768,133	17,213,935	—	17,213,935
(2)セグメント間 の内部売上高 又は振替高	41,875	—	—	41,875	196	42,072	△42,072	—
計	7,775,117	4,654,911	3,057,648	15,487,677	1,768,330	17,256,007	△42,072	17,213,935
セグメント利益	882,740	174,509	600,153	1,657,404	4,990	1,662,395	△25,226	1,637,168

(注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソーブレード、装置部品洗浄、工作機械、表面処理等の事業を含んでおります。

2 セグメント利益の調整額△25,226千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

II 当第1四半期連結累計期間(自平成29年4月1日 至平成29年6月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント				その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注3)
	半導体 等装置関連 事業	太陽電池 関連事業	電子デバ イス事業	計				
売上高								
(1)外部顧客への 売上高	10,026,817	4,386,429	3,223,483	17,636,729	3,156,551	20,793,281	—	20,793,281
(2)セグメント間 の内部売上高 又は振替高	13,109	—	—	13,109	—	13,109	△13,109	—
計	10,039,926	4,386,429	3,223,483	17,649,838	3,156,551	20,806,390	△13,109	20,793,281
セグメント利益又は 損失(△)	1,647,887	△222,008	804,891	2,230,770	46,463	2,277,234	△9,082	2,268,151

(注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソーブレード、装置部品洗浄、工作機械、表面処理等の事業を含んでおります。

2 セグメント利益の調整額△9,082千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントの変更等に関する事項

当第1四半期連結会計期間より従来「装置関連事業」としていた報告セグメントの名称を「半導体等装置関連事業」に変更しております。この変更はセグメント名称の変更であり、セグメント情報に与える影響はありません。

また、これに伴い前第1四半期連結累計期間のセグメント情報も変更後の名称で表示しております。